

## 技術能力 (FPC及びRFPC)

No.	項目	量産能力
1	層数	FPC: 2-6 (層) RFPC: 2-10 (層)
2	完成ワーク板サイズ(最大)	19.7"×19.7"
3	主要材料メーカー	Doosan¥Thinflex¥Shengyi¥ Taiyo¥DongYi
4	完成品板厚公差	±10% ±0.03mm (板厚≤ 0.2mm) ±0.05mm (0.2mm < 板厚 ≤ 0.5mm)
5	ビルトアップ / ブラインドTH	YES
6	最小ドリル孔径	機械ドリル: 0.1mm~6.5mm レーザードリル: 0.1-0.125mm
7	外層基材銅箔厚	1/3 OZ-1OZ (0.012mm -0.035mm)
8	内層基材銅箔厚	1/3 OZ-1OZ (0.012mm -0.035mm)
9	板厚	0.07mm-2.0mm
10	THアスペクト比 (最大)	8:1
11	孔径交差(スルーホールメッキ)	±3mil ( ±0.075mm)
12	孔径公差(非スルーホールメッキ)	±1mil ( ±0.025mm)
13	穴壁銅厚	10um min或いは顧客の要求通り

No.	項目	量産能力
14	内層線幅/スペース (最小)	H/H OZ 3mil/3mil 1/1 OZ 4mil/4mil 2/2 OZ 5mil/5mil 3/3 OZ 6mil/6mil
15	外層線幅/スペース (最小)	H/H OZ 3mil/3mil 1/1 OZ 3mil/3mil 2/2 OZ 4mil/4 mil 3/3 OZ 6mil/6mil
16	レジストダム幅(最小)	2.5mil (0.064mm)
17	レジスト公差	±2mil (±0.05mm)
18	カバーレイダム幅(最小)	8mil (0.2mm)
19	カバーレイ位置決め公差	±6mil (±0.15mm)
20	外形公差 (穴壁から外形端まで最小幅)	±4mil ( ±0.1mm)
21	通電検査能力	PAD Size min (0.1mm) PAD Pitch min (0.4mm)
22	補強材種類	PI/FR4/SUS
23	電磁シールド (EMI)	電磁シールド膜/レジスト銀の オール
24	表面処理	耐熱フラックス (OSP) 、無電 解ニッケル金 (ENIG) 、電解 ニッケル金(Plating Gold)